

展示エリア出展企業・団体

■企業・団体（申し込み順）

- リソテックジャパン株式会社 (<https://www.ltj.co.jp/>)

「 未定 」

- MI-6 株式会社 (<https://mi-6.co.jp/>)

「 AI と研究者の知見を融合し、研究開発を加速させる「次世代の開発スタイル」 」

- ファインネクス株式会社 (<https://www.finecs.co.jp/>)

「 Cu Pillar Pin 及びパワー半導体用スリーブ端子 」

- ミタニマイクロニクス株式会社 (<https://mitani-micro.co.jp/>)

「 フォトマスク、スクリーンマスク 」

- HORIBA (株式会社堀場製作所) (<https://www.horiba.com/jp/>)

(株式会社堀場エステック) (<https://www.horiba.com/jpn/semiconductor/about-us/stec/>)

「 未定 」

- 株式会社栄電子 (<https://sakae-denshi.com/>)

「 BAL SEAL 製品のご照会(仮称) 」

- ジェイエムテクノロジー株式会社 (<https://jmttech.co.jp/>)

「 業務自動化ソリューション【ロボオペレータ】(予定) 」

- 株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ (<https://www.screen.co.jp/spe/>) 2 ブース

「 SCREEN の半導体製造装置およびソリューション 」

- 奥野製薬工業株式会社 (<https://www.okuno.co.jp/>)

「 ・セラミック基板上焼結導体回路への無電解めっきプロセス

・ガラス基板へのトータルめっきプロセス 」

- 株式会社村田製作所 (<https://www.murata.com/ja-jp>)

「 排気循環濃縮装置 」

- ローム株式会社 (<https://www.rohm.co.jp/>)

「 エンドポイント AI チップ”Solist-AI™”による機械設備等の異常の予兆検知 」

- 株式会社東設 (<https://www.toetzt.com/>)

「 ①脱気システム ②電解めっき 」

- Vanguard Automation GmbH (<https://www.vanguard-automation.com/>)

マイクロニクテクノロジー株式会社 (<https://www.micronic.com/>)

「 フォトニック・ワイヤーボンディングおよびマイクロレンズを用いた、実用レベルの光電融合技術

Industry Ready Photonic Integration using Photonic Wire Bonds and Facet-Attached Micron-Lenses 」

- 住友精密工業株式会社 (<https://www.spp.co.jp/>)

「 光・高周波デバイスの製造と実装を支えるプラズマプロセス技術 」

■大学関係：テーマ「文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)の取組」 3 ブース

- 京都大学(ナノハブ拠点) (<http://www.kyoto-u.ac.jp/ja>)

- 大阪大学 (<https://www.osaka-u.ac.jp/ja>)

- 奈良先端科学技術大学院大学 (<http://www.naist.jp/>)

- 山形大学 (<http://www.yamagata-u.ac.jp/>)

- 京都大学(ARIM 運営機構) (<http://www.kyoto-u.ac.jp/ja>)